

# TSE

Enabling Tomorrow's  
Semiconductor

(주) 티에스이

2025 Investor Relations

[www.tse21.com](http://www.tse21.com)





## Disclaimer

---

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 (주)티에스이(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다. 본 presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

# Table of Contents

- 01. 회사 소개
- 02. 상반기 실적
- 03. 향후 전망
- 04. 요약 재무정보

**TSE**

Enabling Tomorrow's Semiconductor

# TSE

## 01. 회사 소개

1-1. 회사 개요

1-2. 티에스이 그룹

1-3. 티에스이 경쟁력

1-4. 티에스이 사업 부문

1-5. 티에스이 제품 적용 공정

Enabling Tomorrow's  
Semiconductor

# 1-1. 회사 개요

## ■ 회사 소개

설립자 / 회장	권 상 준	사업분야	반도체 / 디스플레이
대표이사	김 철 호, 김 명 진	임직원	867명 (2025년 2분기 기준)
설립일	1994년 3월 1일	매출액 (별도)	2,210억 (2024년 기말 기준)
코스닥 상장	티에스이 (2011), 타이거일렉 (2015), 엘디티 (2008), 메가터치 (2023)	자산 총액 (별도)	3,728억 (2024년 기말 기준)

## ■ 자회사

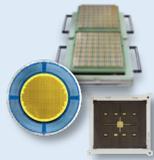


# 1-2. 티에스이 그룹

## Semiconductor

### TSE

- Test InterconneXion Hardware  
Probe Card, Interface Board, Test Socket



### TIGERELEC

- 반도체 검사용 고다층 PCB  
MLB, Build-up, STO



44%

### MEGATOUCH

- Pogo Pin / Interposer



57%

### GMTTEST

- Semiconductor Test House



82%

### LDT

- SSN & Drive IC Fabless  
Safemate, PMOLED, LED, Optic



30%

## Display

### TSE

- OLED Array Tester & Prober



### MEGASEN

- Prober & Inspection System



65%

## 해외법인

### • TSE WORKS (미국)

영업, 서비스

100%

### • TAISI TECHNOLOGY(중국)

검사 장치

100%

### • Taisi Semicon(중국)

검사 장치

100%

### • Weihai TSE(중국)

검사 장치

100%

### • Megaelec (베트남)

반도체 검사용 고다층 PCB(MLO)

100%

## Battery

### MEGATOUCH

- Battery Pin
- Battery Gripper



57%

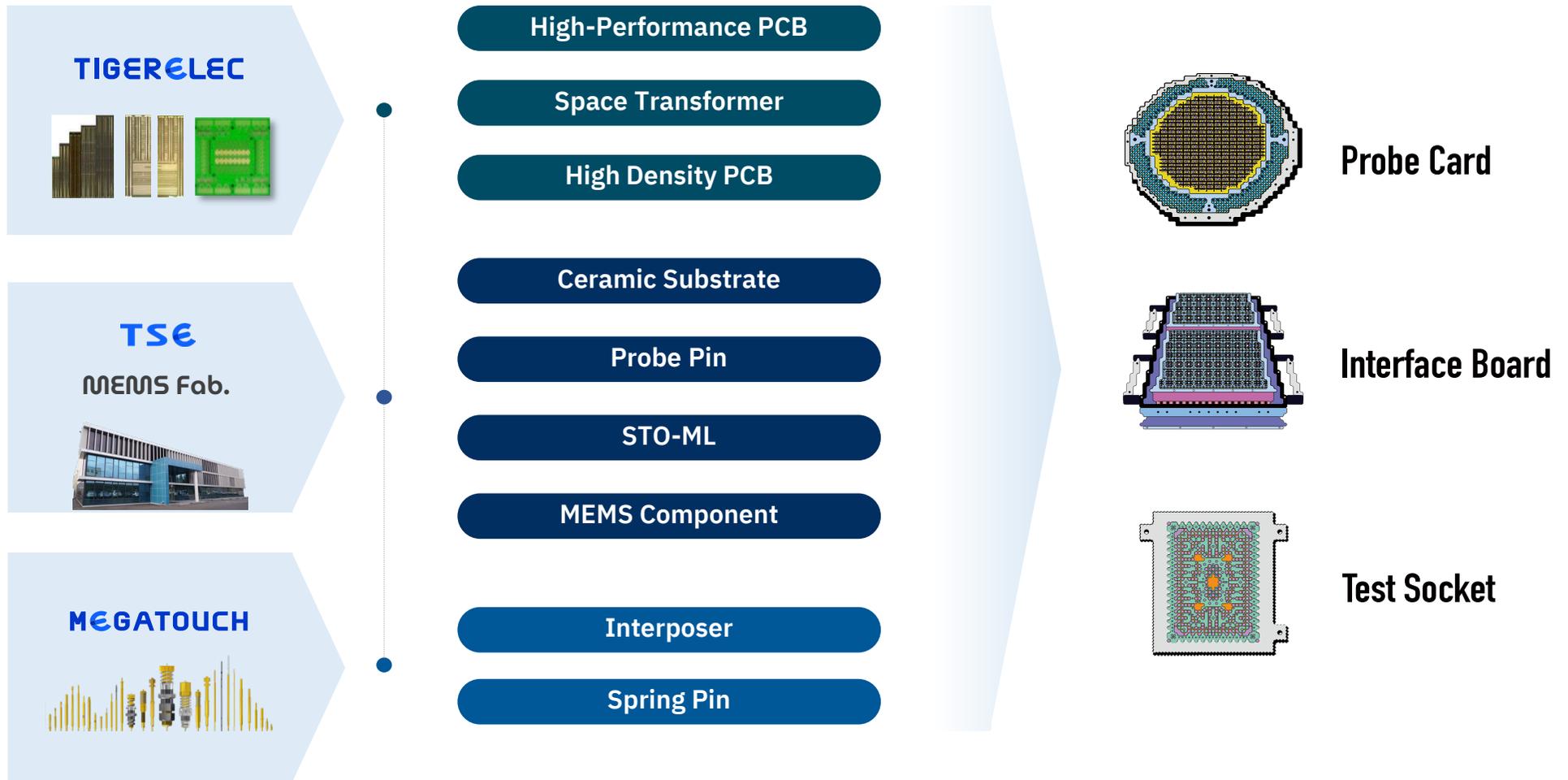
## TSE 그룹사 유형

코스닥 상장 그룹사

비상장 그룹사

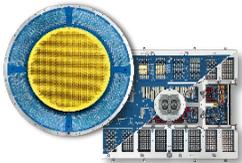
# 1-3. 티에스이 경쟁력

핵심 부품을 자체 생산하여 수직적 통합을 실현함으로써,  
제품 경쟁력을 강화하고 품질·납기·성능 측면에서 차별적 우위를 확보합니다.



“TSE는 반도체 테스트 인터페이스 하드웨어 및 OLED 테스트 장비 사업 분야의 글로벌 리더입니다”

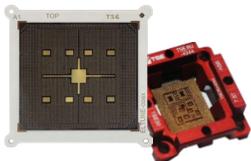
## 반도체 (Semiconductor)



**Probe Card**  
프로브카드



**Test Interface Board**  
테스트 인터페이스 보드



**Test Socket**  
테스트 소켓

## 디스플레이 (Display)



**OLED, u-OLED, u-LED**

# 1-5. 티에스이 제품 적용 공정

- 티에스이의 주요 제품인 Probe Card 는 반도체 전 공정이 완료된 웨이퍼를 검사하는 웨이퍼 테스트 공정에 적용되며, Interface Board와 Test Socket은 후 공정을 통하여 완료된 패키지를 검사하는 패키징 테스트에 적용됩니다.



# TSE

## 02. 상반기 실적

2-1. 별도 기준

2-2. 연결 기준

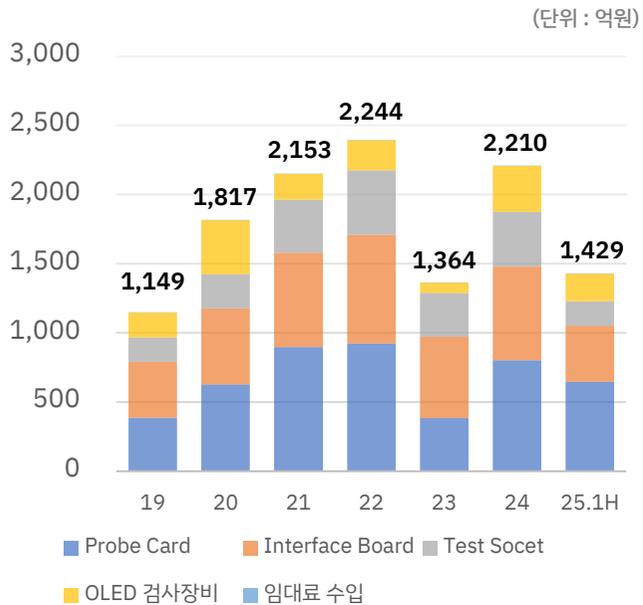
Enabling Tomorrow's  
Semiconductor

# 2-1. 별도 기준

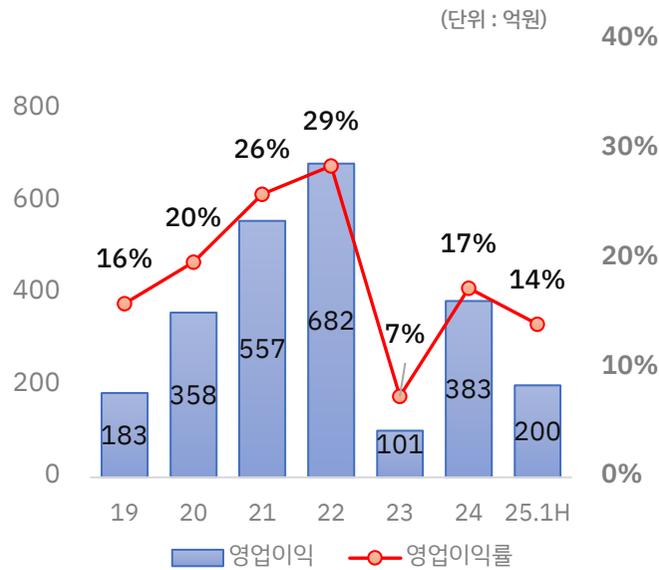
## ■ 신제품 및 신규고객 확보 지속성장

- **매출액**: 당사 신규 고객사 확보 및 신제품 매출의 증가로 2025년 상반기 매출은 전년 상반기 대비 80% 성장하였음  
반도체 부문 매출은 24년 상반기 689억에서 25년 상반기 1,227억으로 78% 성장하였고, 수출비중은 68%입니다.
- **영업이익**: 신규 고객 및 신제품 매출 증가로 2025년 상반기 영업이익은 200억원으로 전년 상반기 대비 389% 증가하였습니다.

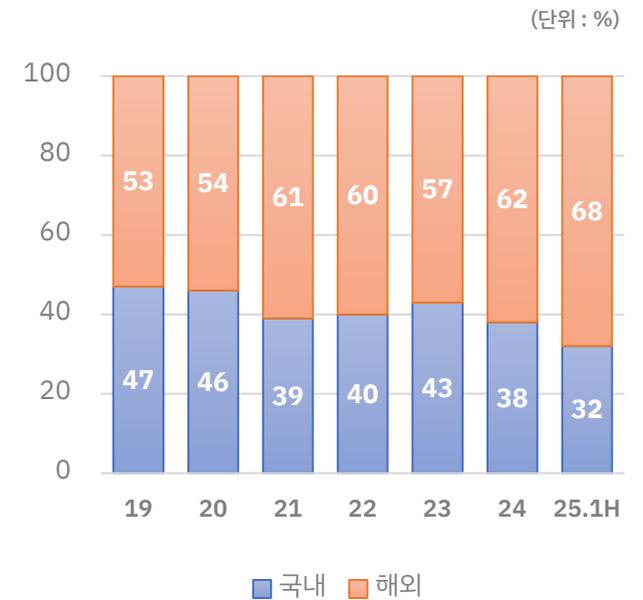
매출액



영업이익



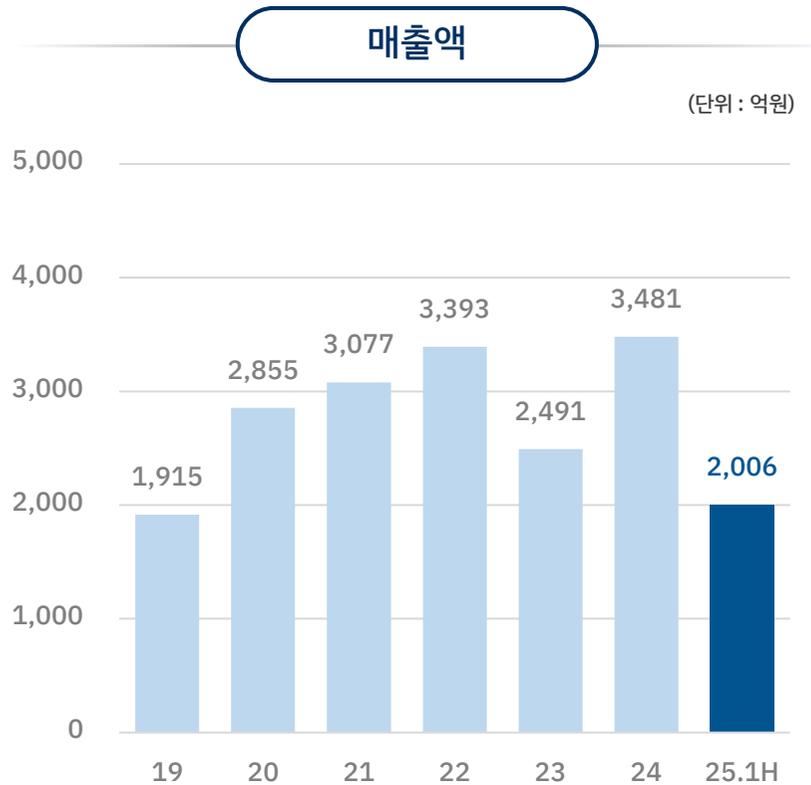
연도별 해외 매출



## 2-2. 연결 기준

### ■ 반도체, 디스플레이 부분 성장 지속

- **매출액**: 반도체 및 디스플레이 시장 성장과 신제품 판매 증가로 2025년 상반기 매출은 2,006억원으로 전년 동기 대비 49% 성장하였습니다.
- **영업이익**: 매출과 신제품 판매 증가로 2025년 상반기 영업이익은 347억원으로 전년 동기 대비 520% 성장하였습니다.



# TSE

## 03. 향후 전망

3-1. Test Interface Board

3-2. Test Socket

3-3. Probe Card

3-4. OLED Test System

Enabling Tomorrow's  
Semiconductor

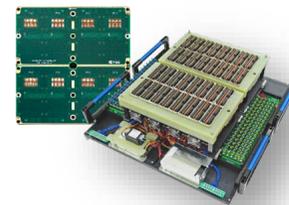
# 3-1. TIB (Test Interface Board)

- 특화된 기술력과 글로벌 시장 경쟁력을 기반으로, AI와 자율주행 등에 활용되는 고대역·고전력 수요 증가에 따라 비메모리 분야 시장 확대를 통해 매출 성장을 추진하고 있습니다.

## Board Vendors Market Share

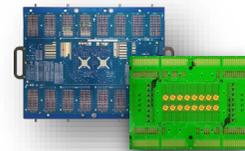
Rank	Company	Region	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Technoprobe	EU	-	-	-	-	13.64	128.64
2	Advantest	JP	-	-	-	-	67.04	84.50
3	TSE	KR	48.91	63.54	84.36	85.57	65.18	64.77
4	CHPT	TW	65.89	69.60	70.39	47.61	41.89	58.10
5	Gorilla Circuits	NA	33.50	30.80	33.66	34.95	30.30	34.60
6	Synergie CAD	EU	25.15	28.59	32.29	34.65	32.60	34.00
7	CMRSummit	NA	24.40	25.82	28.80	32.12	27.10	27.94
8	Zero One	CH	-	-	-	-	26.51	27.30
9	ZenFocus	CH	15.93	18.40	22.16	26.90	21.80	27.05
10	Ace Tech Circuit	KR	25.69	24.58	32.23	30.86	26.57	26.73
11	Sanmina	NA	20.50	21.00	25.26	30.39	24.67	25.41
12	Integrated Test Corp.	NA	32.14	28.78	34.85	37.30	22.73	25.00
13	Di	KR	19.99	25.73	53.41	31.43	36.55	24.34
14	ESA Electronics	SG	12.00	16.00	18.00	20.00	21.00	22.00
15	GigaForce	CH	18.48	17.92	20.59	21.62	20.50	21.12
16	Lincstech	JP	14.00	17.64	19.53	21.52	19.68	20.27
17	Hampoo	CH	15.20	13.92	16.81	17.23	17.08	19.30
18	Dynamic Test Solutions	ROW	18.20	17.22	18.73	19.68	18.50	18.80
19	Meritech	KR	5.00	4.60	8.34	12.42	17.40	18.09
20	TFE	KR	9.02	13.70	21.90	17.51	17.31	16.60

(출처 : YOLE Intelligence)



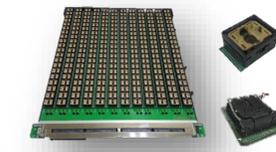
## Interface Board

메모리 반도체 DRAM 및 FLASH 등 디바이스의 전기적 특성과 더불어 동시에 최대 960개의 디바이스 테스트 솔루션 제공



## Load Board

시스템 반도체 CPU, GPU, AP 등 디바이스의 고주파 신호 무결성과 전원 무결성 특성 최적화된 테스트 솔루션 제공



## Burn In Board

메모리 반도체인 DRAM 및 FLASH 등 디바이스의 장기 신뢰성 검증을 위한 고온 테스트 환경의 테스트 솔루션 제공

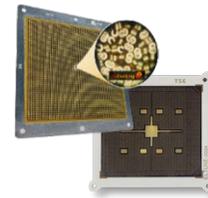
## 3-2. Test Socket

- Elastomer 소켓 뿐만 아니라 포고 소켓 시장 확대를 추진하고 있으며, MEMS 기술의 강점을 살린 Singulated Die Test에 특화된 Die Carrier Solution을 통해 새로운 시장에서 업계 표준을 만들어가고 있습니다.

### Test Socket Vendors Market Share

Rank	Company	Region	2020	2021	2022	2023	2024
1	Yamaichi	JP	118.84	154.40	183.34	105.06	157.55
2	WinWay	TW	66.01	68.80	104.64	102.86	146.43
3	LEENO	KR	94.61	133.69	132.50	114.08	116.39
4	Cohu	NA	114.50	119.00	130.00	123.96	112.60
5	Enplas	JP	115.70	120.79	158.91	115.99	100.32
6	ISC	KR	88.43	97.18	83.14	73.53	84.78
7	Advantest	JP	53.01	60.61	82.09	67.48	80.00
8	Yokowo	JP	93.68	105.04	122.73	64.52	73.38
9	Smiths Interconnect	EU	36.90	43.31	68.80	77.00	63.00
10	BOYD	NA	-	-	72.00	53.00	47.55
11	MCS	KR	30.13	46.88	42.52	44.73	40.25
12	Loranger	NA	33.00	35.20	37.20	35.31	37.44
13	TTS	SC	39.10	41.85	40.20	40.20	35.40
14	Okins	KR	24.99	39.87	40.65	32.82	31.36
15	KZT	CH	22.66	24.02	27.60	25.24	28.54
16	Johnstech	NA	27.50	32.18	38.00	29.70	28.40
17	TSE	KR	20.19	31.38	31.40	22.72	23.30

(출처 : YOLE Intelligence)



### Elastomer Socket

- MRC - High Performance Socket (20GHz)
- ELTUNE - Impedance Tuned Socket (40GHz)
- ELTUNE-coax – Coaxial Elastomer Socket (60GHz)



### Spring Loaded Pin Socket

- Pogo - Spring Pin Socket
- Tango - High Current Spring Pin Socket
- FlexTUNE - Coaxial Spring Pin Socket



### Die Carrier & Loader

- KGD (Known Good Die) Test Solution
- WLCSP Die & HBM Die Test Solution
- Die carrier loader is use for loading and unloading the Die onto the Die Carrier.



### Change Over Kit (COK)

- Memory Handler COK
- LSI Handler COK

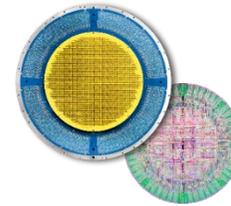
## 3-3. Probe Card

- DRAM 및 HBM용 Probe Card 고객 확보를 통해 지속적인 매출 성장을 기록하고 있으며, Global CS망 구축으로 고객 신뢰도를 높여 신규 거래선 확보 및 M/S 확대를 성장 추진하고 있습니다.

### Global Memory Probe Card Market Share

No	Memory Probe Cards		2020	2021	2022	2023	2024
1	Micronics Japan	JP	235.26	275.27	253.16	226.40	313.27
2	FormFactor	NA	135.55	197.60	182.20	134.30	244.70
3	JEM	JP	98.03	123.87	83.41	58.34	67.59
4	Korea Instrument	KR	46.43	54.76	68.48	52.08	58.05
5	TSE	KR	51.01	73.85	63.03	27.42	56.49
6	Soulbrain SLD	KR	17.38	22.16	41.63	37.95	39.46
7	Microfriend	KR	42.86	51.20	27.91	24.37	16.83
8	Max One	CH	2.03	4.37	6.15	6.31	9.17
9	Micro to Nano	KR	18.88	26.47	30.06	6.04	6.41
10	STAr Technologies	TW	-	0.80	3.68	4.96	4.92
11	AMST	KR	21.93	20.49	21.28	3.47	3.12
12	LEENO	KR	7.57	5.00	4.44	2.58	3.03
13	Will Technology	KR	0.46	0.62	0.41	1.14	1.50
14	Translarity	NA	-	1.23	1.67	1.50	1.40
15	Suzhou Silicon Test Sys.	CH	1.14	1.24	1.21	1.10	1.25
16	Shenzhen Doctor Tech.	CH	0.58	0.93	1.17	0.80	1.05
17	Wentworth Labs.	NA	0.20	0.40	0.50	0.41	0.40
18	MPI Corp.	TW	0.31	0.21	0.07	0.07	0.11
19	Gigalane	KR	1.95	2.24	1.93	-	-
20	NHK Spring	JP	3.12	2.19	-	-	-
21	Advantest	JP	4.50	-	-	-	-
22	Other Vendors	n/a	10.78	11.50	10.95	10.20	10.69
Memory Probe Cards			699.97	876.40	803.34	599.44	839.44

(출처 : YOLE Intelligence)



### DRAM, FLASH, HBM

- High Speed Probe Card
- 12인치 웨이퍼 1 shot test
- Min Pitch 50 $\mu$ m 대응

### 비메모리 (System)

- Vertical Probe Card
- AP (SoC), CPU, GPU, PMIC, ASIC, CIS
- 40 마이크로미터( $\mu$ m) 간격으로 전체 배열 가능

### STO / STO-ML

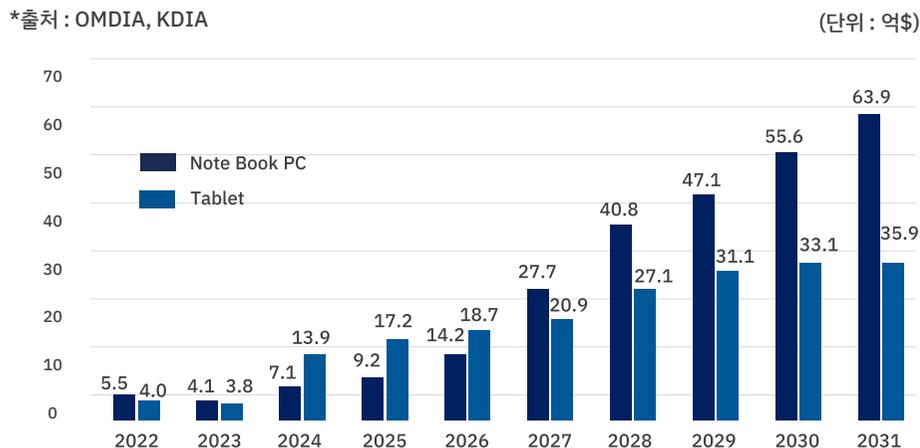
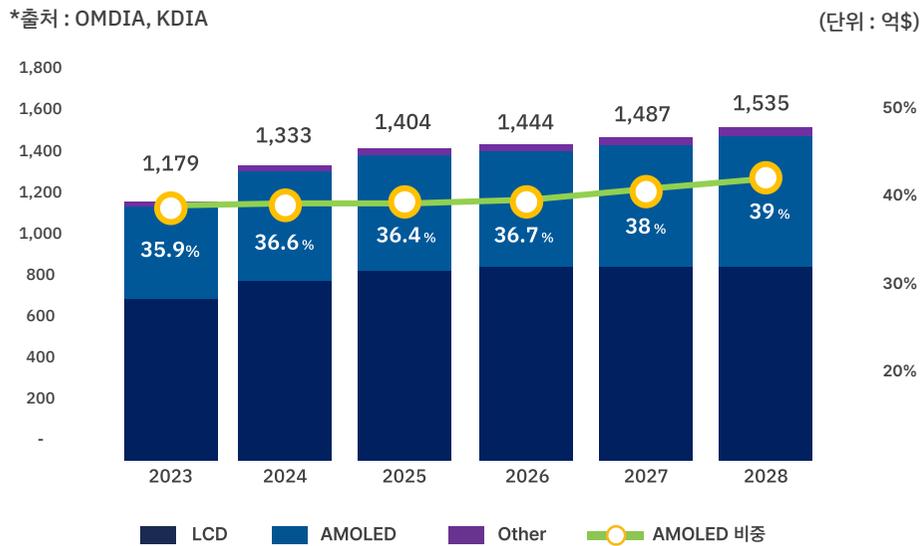
- Space Transformer Organic-Multi Layer
- VPC의 Load Board와 Probe Head 사이의 초 미세 피치 (30 $\mu$ m) 테스트 환경의 PCB 솔루션 제공

### Probe Unit - OLED

- 디스플레이 패널과 모듈 테스트유닛
- OLED, LCD, u-LED, u-OLED

# 3-4. OLED Test System

- 전체 디스플레이 시장규모에서 AMOLED 비중은 2028년 39%까지 확대되며, OLED 기반 노트북, PC 및 Tablet용 디스플레이 수요 증가로 설비투자가 예상되며 당사도 매출 성장을 준비하고 있습니다.



## ATS

AMOLED Pixel회로를 전기적 측정 방법을 이용하여 Panel의 불량 여부를 검사하는 장치



## OLEDoS

μ-OLED Wafer의 OLEDoS Pixel 회로를 전기적 검사를 통해 불량 여부를 검사하는 장치



## CDS7 – Cell Defect Search

OLED Panel의 불량을 분석하는 장치

# TSE

# Q&A

Enabling Tomorrow's  
Semiconductor

# TSE

## 요약 재무정보

1-1. 요약 재무정보 (별도)

1-2. 요약 재무정보 (연결)

Enabling Tomorrow's  
Semiconductor

# 1-1. 요약 재무정보(별도)

## 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.1H
유동자산	146,522	160,699	139,437	188,675	172,086
비유동자산	130,121	155,727	167,782	184,148	197,371
자산총계	276,643	316,426	307,219	372,823	369,457
유동부채	36,365	30,757	22,627	37,456	29,417
비유동부채	5,555	8,772	5,707	5,994	5,719
부채총계	41,920	39,529	28,334	43,450	35,136
납입자본	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720
기타자본	4,632	15,424	8,790	13,617	13,617
기타포괄손익 누계액	7,478	6,470	10,071	5,053	3,243
이익잉여금 (결손금)	199,892	232,283	237,304	287,983	294,741
자본총계	234,723	276,897	278,885	329,373	334,321

## 손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.1H
매출액	215,277	224,361	136,378	220,996	142,915
매출원가	130,685	147,830	103,833	150,572	100,580
매출총이익	84,591	76,531	32,545	70,423	42,335
판매비와 관리비	28,867	31,903	22,441	32,104	22,313
영업이익	55,724	44,627	10,104	38,319	20,022
기타수익	824	494	601	1,311	775
기타비용	198	2,846	268	478	367
금융수익	10,999	11,656	6,445	16,597	2,664
금융비용	660	4,371	4,528	2,239	9,472
법인세비용 차감전순이익	66,688	49,561	12,354	53,509	13,622
법인세비용	16,600	11,848	1,895	10,393	2,548
당기순이익	50,087	37,713	10,459	43,116	11,074

# 1-2. 요약 재무정보(연결)

## 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.1H
유동자산	192,217	228,247	207,346	268,896	251,004
비유동자산	179,572	207,589	235,775	250,512	261,433
자산총계	371,789	435,836	443,121	519,408	512,437
유동부채	75,619	71,584	65,333	94,755	85,134
비유동부채	25,991	33,476	29,964	24,955	27,745
부채총계	101,610	105,060	95,297	119,710	35,136
납입자본	22,720	22,720	22,720	22,720	22,20
기타자본	2,158	8,282	13,812	18,639	18,639
기타포괄손익 누계액	7,849	6,689	10,301	5,098	2,921
이익잉여금 (결손금)	207,326	252,170	246,486	296,314	299,351
비지배지분	30,125	40,915	54,505	56,927	55,927
자본총계	270,179	330,776	347,824	399,698	399,558

## 손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.1H
매출액	307,663	339,264	249,148	348,053	200,645
매출원가	209,839	239,867	215,558	261,048	147,067
매출총이익	97,823	99,397	33,590	87,005	52,578
판매비와 관리비	43,179	42,771	35,970	47,106	34,658
영업이익	54,644	56,626	(2,380)	39,899	17,920
기타수익	984	1,021	773	1,157	827
기타비용	2,273	561	479	699	467
금융수익	12,627	17,069	8,279	22,922	4,053
금융비용	2,522	9,335	9,544	7,461	13,968
지분법손익	663	581	(42)	(339)	52
법인세비용 차감전순이익	64,123	65,402	(3,393)	55,477	8,416
법인세비용	20,888	12,036	(1,298)	10,445	2,065
당기순이익	43,235	53,365	(2,095)	45,032	6,351